

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2025-04

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述及进展情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2024年3月18日、2024年4月9日分别召开第六届董事会第十二次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合并报表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币566,680万元，其中公司拟对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为66,700万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为499,980万元。

上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为准。具体内容详见公司于2024年3月19日披露在巨潮资讯网上《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。

近日，公司作为保证人与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《保证合同》，为深圳市梦启半导体装备有限公司的融资贷款提供担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市梦启半导体装备有限公司

1、成立时间：2021年02月04日

2、住所：深圳市光明区公明街道上村社区元山工业区B区第34栋201

3、法定代表人：胡敬祥

4、注册资本：5,000万元

5、经营范围：提供集成电路、半导体器件和半导体设备的维修维护、技术服务和技术咨询，从事上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）研发、生产、销售、租赁半导体设备、耗材、半导体及电子元器件、电子产品、电器、仪器仪表；集成电路和半导体器件加工制造、测试服务。

6、股权结构：公司直接持有深圳市梦启半导体装备有限公司51%的股权；梦启一号创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）持有9%的股权，剩余40%股权由深圳方达半导体装备有限公司持有，该公司的主要股东为胡敬祥，对其持股67.25%。

7、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目名称	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,648.26	4,671.72
负债总额	4,326.39	2,359.34
其中：银行贷款总额	689.66	-
流动负债总额	4,115.62	1,948.96
净资产	1,321.87	2,312.37
	2024年1月至9月	2023年1月至12月
营业收入	395.79	1,671.03
利润总额	-990.51	-1,133.24
净利润	-990.51	-1,133.24

三、保证合同或担保文件的主要内容

（一）被担保人：深圳市梦启半导体装备有限公司

（1）债权人：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行

（2）保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司

（3）债务人：深圳市梦启半导体装备有限公司

（4）担保最高限额：人民币300万元

（5）保证方式：连带责任保证

（6）保证范围：保证人保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率

损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（7）保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 4 月 8 日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币 195,481.06 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益 580,333.47 万元的比例为 33.68%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署的《保证合同》；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月九日